

チップ部品選別整列System

バラ置きされたチップ部品を選別整列します

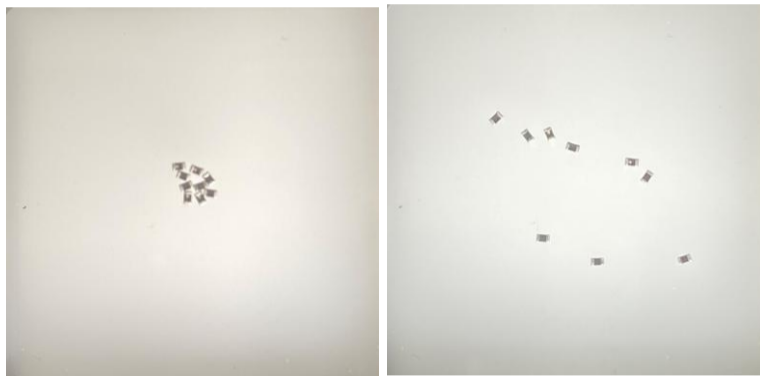


特長

- ・エリアカメラ(画像処理機能)にて部品品種、方向を選別可能。
- ・グripper先端への部品付着除去機能搭載。特許出願中の当社独自機能。
- ・ピッキング部に弊社製 超音波モータを採用。無振動・無発熱にてピッキング可能。
- ・用途に合わせたグripper(TGH-1011)搭載

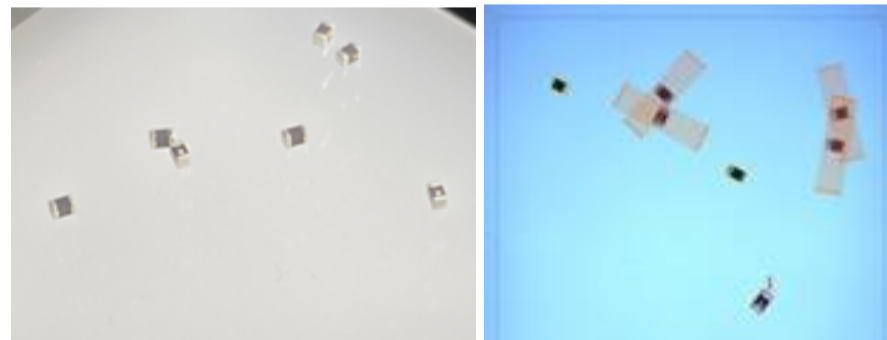
部品分離

- ・振動によりバラ積み部品を分離
置き台の形状は客先対応



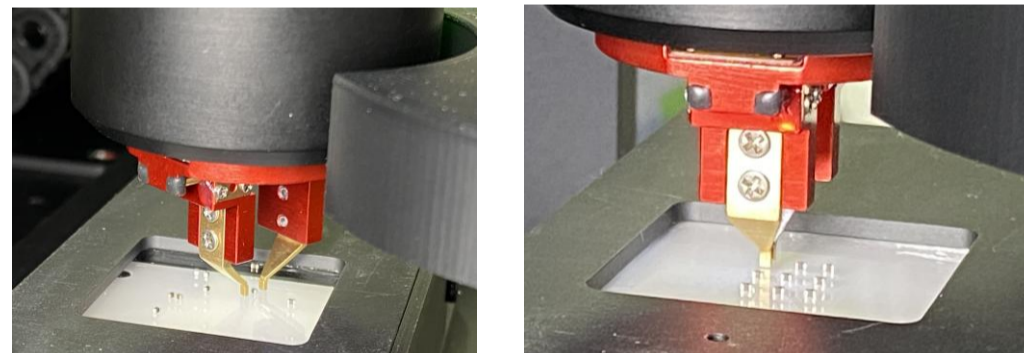
部品認識

- ・エリアカメラにて部品位置・形状を認識



ピッキング

- ・タッチ機能により正確な把持
超音波モータにより無振動、無発熱ピッキング

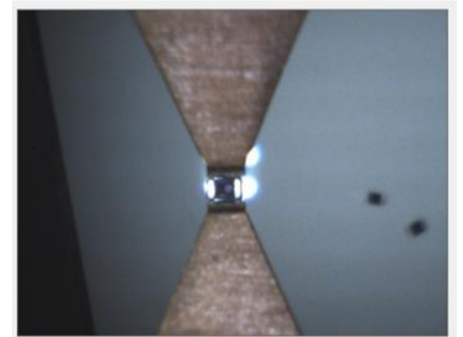


部品付着除去

- ・部品付着除去機能AVWにより部品の正確搬送を実現

ピッキングカメラ

- ・ピッキング映像の確認が可能



整列

- ・部品を定位置、定方向に高精度に整列
整列皿の形状は客先対応



ハード仕様

タクトタイム	平均9秒 / 1個
X軸	ストローク: 250mm / 分解能: 0.1μm
Y軸	ストローク: 100mm / 分解能: 0.1μm
Z軸	ストローク: 100mm / 分解能: 0.1μm
θ軸	ストローク: 180° / 分解能: 0.0024°
部品認識カメラ	画素数: 4000x3000 (カラー) / 視野範囲: 30x30mm
ピッキングカメラ	画素数: 1312x816 (カラー) / 視野範囲: 画角40°
グripper	最大開き幅: 5mm / 推力: 35~90g 保持力150g
対応チップ部品	0402 <
電源	AC90-200V / 2A

Micro Parts Picking System

MPPS-標準ソフトウェア

特長

- ・プログラム実行中に、各種情報の確認が可能。
- ・アライメント測定により、微小部品の正確なピッキング処理を実現。
- ・部品登録時に、ピッキング処理の確認が可能。
- ・簡単なプログラムにて、ピッキング処理が可能。
- ・AI機能により、最適な順番でのピッキング処理を実行。
- ・オフラインにて、プログラムと保管位置の編集が可能。

メイン画面

プログラム実行中の各種情報
進行状況、部品認識&ピッキング状態を確認できます。

アライメント

供給部、保管部のアライメント
底面をタッチ機能にて測定し、位置と傾きを
取得することで、正確なピッキング処理を実現できます。

部品登録

部品名とパラメータの設定
プログラムを実行することなく、部品の認識状態
(外形判定、表面判定)を確認できます。

保管位置登録

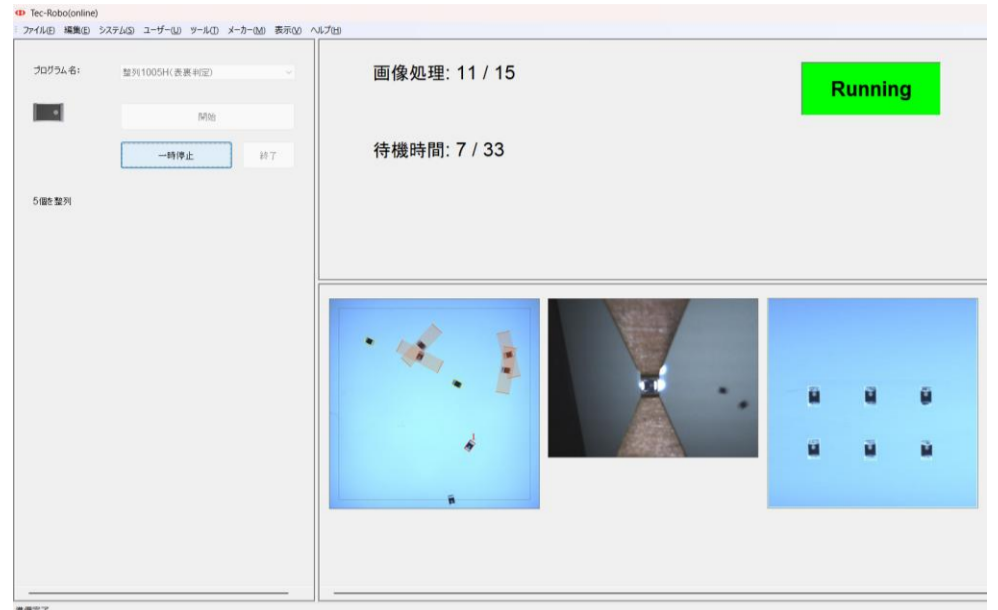
保管名と位置の設定
多点パラメータ(方向、個数、ピッチ)を入力することで、
一括で保管(整列)位置を作成できます。

プログラム作成

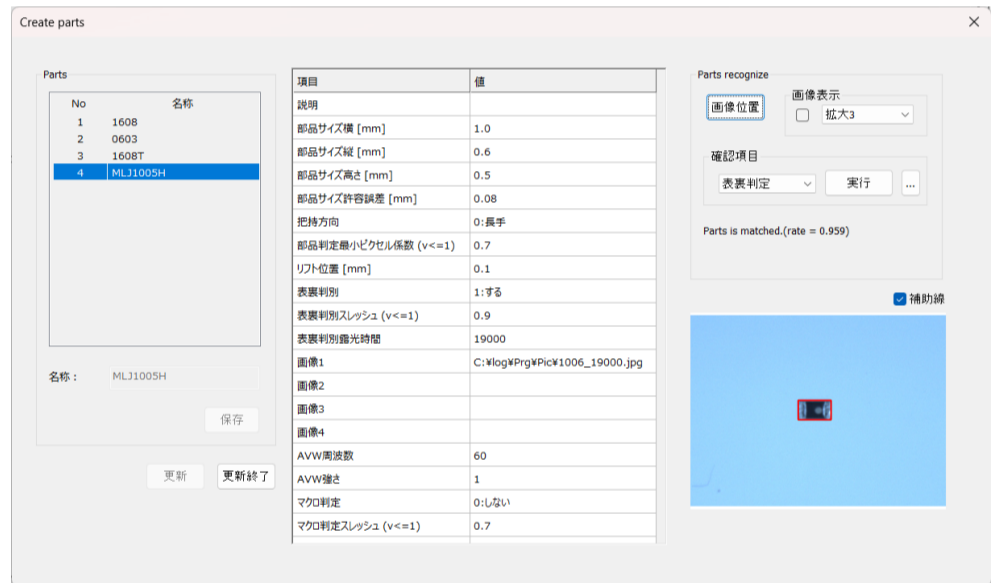
プログラム名とパスの設定
画像&整列処理コマンドには、必要なコマンドが
組込まれているので、簡単にパスを作成できます。

- [主なコマンド]
- ・位置指定、速度
 - ・パラメータ
 - ・部品名、保管名
 - ・画像処理
 - ・整列処理
 - ・ツール

メイン画面



部品登録



プログラム作成

